# 证券代码：688372 证券简称：伟测科技

**上海伟测半导体科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2024-006

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | 特定对象调研 分析师会议  媒体采访 业绩说明会  新闻发布会 路演活动  现场参观 电话会议  其他 |
| **参与单位名称** | 线上参与2024年半年度业绩说明会的投资者 |
| **时间** | 2024年10月9日 |
| **地点** | 上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事长、总经理骈文胜先生  董事、副总经理、董事会秘书、财务总监王沛女士  独立董事宋海燕女士 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司在上海证券交易所上证路演中心举行了2024年半年度业绩说明会，现将互动交流内容汇总如下：  **1、请问伟测科技为何今年增收不增利？和同行业比较以及和公司往年同期比较，公司的毛利率处于什么水平？**  答：公司今年上半年营业收入较上年同期大幅增长，但是公司净利润较上年同期有所下降，主要由于新建产能的产能利用率处于爬坡期导致各类固定成本上升，股份支付费用和研发费用增加。2024年上半年，公司的毛利率水平高于国内行业可比公司，变动趋势与可比公司接近；略低于3家台资巨头的平均水平和公司往年同期水平，一方面因为公司2023年逆周期进行产能扩张的幅度较大，固定成本上升较多所致，另一方面因为3家台资巨头的业务更加多元化，业务更加稳健，并且受人工智能等高端测试业务的拉动更加明显。  **2、请问公司在目前市场环境下有哪些技术优势，目前的市场表现如何？**  答：公司的技术先进性主要体现在测试方案开发能力强、测试技术水平领先和生产自动化程度高三个方面。在测试方案开发方面，公司突破了5G射频芯片、高性能CPU芯片、高性能算力芯片、FPGA芯片、复杂SoC芯片等各类高端芯片的测试工艺难点，成功实现了国产化。在测试技术水平方面，公司在晶圆尺寸覆盖度、温度范围、最高Pin数、最大同测数、Pad间距、封装尺寸大小、测试频率等参数上保持国内领先，并与国际巨头持平或者接近。在测试作业的自动化方面，公司对标国际巨头，通过将测试作业中积累的技术和经验融入IT信息系统，自主开发了符合行业特点的生产管理系统，提升了测试作业的信息化、自动化、智能化水平，提高了测试作业的准确率和效率。  **3、麻烦请问公司未来的分红计划和派息政策？**  答：在符合利润分配、满足现金分红的条件前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，未来三年（2024年至2026年）的每年现金分红金额均不低于对应年度归属于上市公司股东净利润的30%。 |
| **风险提示** | 以上如涉及对行业的预测、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的盈利预测和承诺，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |